

청구범위

- [청구항 1] 내상;
외상; 및
상기 내상 표면을 둘러싸 계면을 형성하는 복수의 계면입자를 포함하고,
상기 계면입자는 입자 크기가 내상보다 작고,
상기 계면입자는 유기 입자를 포함하는 것인, 유화 조성물.
- [청구항 2] 제 1항에 있어서,
상기 내상은 1 내지 50 μm 의 평균 크기를 갖는 것인, 유화 조성물.
- [청구항 3] 제 1항에 있어서,
상기 계면입자는 평균 입자 크기가 내상 평균 크기의 1/5,000 내지 1/2인,
유화 조성물.
- [청구항 4] 제 1항에 있어서,
상기 계면입자는 평균 입자 크기가 10 nm 이상 내지 1 μm 미만인, 유화 조성물.
- [청구항 5] 제 1항에 있어서,
상기 계면입자는 내상 표면에서 연속적으로 위치하여 내상과 외상
사이에 계면을 형성하는 것인, 유화 조성물.
- [청구항 6] 제 1항에 있어서,
상기 계면입자는 무기 입자를 더 포함하는 것인, 유화 조성물.
- [청구항 7] 제 1항에 있어서,
상기 유화 조성물은 유화제로 콜로이드 용액을 포함하고,
상기 콜로이드 용액은 분산 매질과 상기 분산 매질에 분산된 유기 입자를
포함하고,
상기 콜로이드 용액의 분산 매질은 유화 조성물의 외상과 혼화성이며
유화 조성물의 내상과 비혼화성이고,
상기 유화제로 유화 후 상기 분산 매질은 외상에 혼입되고 상기 분산
매질에 분산된 유기 입자는 내상 표면을 둘러싸는 것인, 유화 조성물.
- [청구항 8] 제 7항에 있어서,
상기 콜로이드 용액은 유화 조성물 전체 중량을 기준으로 7 내지 30
중량%로 포함된 것인, 유화 조성물.
- [청구항 9] 제 1항에 있어서,
상기 유기 입자는 유화 조성물의 외상에만 분산되고 내상에는 분산되지
않는 것인, 유화 조성물.
- [청구항 10] 제 1항에 있어서,
상기 유기 입자는 나노에멀전 입자 (Nanoemulsion Particle), 고체 지질
나노 입자 (Solid Lipid Nanoparticle, SLN), 리포솜 (Liposome) 및 폴리머솜
(Polymersome)으로 이루어진 군에서 선택되는 것인, 유화 조성물.

- [청구항 11] 제 1항에 있어서,
상기 유기 입자는 효능 성분을 포함하는 것인, 유화 조성물.
- [청구항 12] 제 11항에 있어서,
상기 효능 성분은 바쿠치올 또는 레티놀을 포함하는 것인, 유화 조성물.
- [청구항 13] 제 11항에 있어서,
상기 효능 성분은 유기 입자에 담지된 것인, 유화 조성물.
- [청구항 14] 제 11항에 있어서,
상기 효능 성분은 유화 조성물 전체 중량을 기준으로 0.0001 내지 10 중량%로 포함된 것인, 유화 조성물.
- [청구항 15] 제 1항에 있어서,
상기 유화 조성물은 화장료 조성물인, 유화 조성물.
- [청구항 16] 제 1항에 있어서,
상기 유화 조성물은 계면활성제를 더 포함하는 것인, 유화 조성물.
- [청구항 17] 제 1항에 있어서,
상기 유화 조성물은 점증제를 더 포함하는 것인, 유화 조성물.
- [청구항 18] 제 1항에 있어서,
상기 유화 조성물은 전단 응력에 따른 점도를 측정하였을 때, 항복 응력 (yield stress)이 0.1 내지 1.0 Pa인, 유화 조성물.
- [청구항 19] 제 18항에 있어서,
상기 유화 조성물은 상기 0.1 내지 1.0 Pa의 항복 응력을 기점으로 점도가 30% 이상 감소하는 것인, 유화 조성물.
- [청구항 20] 제 1항에 있어서,
상기 유화 조성물은 전단 응력에 따른 점도를 측정하였을 때, 100 내지 1,000 Pa의 전단 응력 (shear stress) 구간 중 적어도 일부에서 전단 응력이 증가함에 따라 점도가 증가하는 구간을 나타내는 것인, 유화 조성물.
- [청구항 21] 제 1항에 있어서,
상기 유화 조성물은 동결건조 제형을 갖는 것인, 유화 조성물.
- [청구항 22] 제 1항 내지 제 21항 중 어느 한 항에 따른 유화 조성물을 제조하는 방법으로,
분산 매질과 상기 분산 매질에 분산된 유기 입자를 포함하는 콜로이드 용액을 제조하는 단계;
수상부를 제조하는 단계;
유상부를 제조하는 단계; 및
상기 콜로이드 용액, 수상부 및 유상부를 혼합하여 내상, 외상 및 상기 내상 표면을 둘러싸 계면을 형성하는 복수의 계면입자를 포함하는 유화 조성물을 제조하는 단계를 포함하고,
상기 계면입자는 입자 크기가 내상보다 작고, 상기 계면입자는 유기 입자를 포함하는 것인, 유화 조성물을 제조하는 방법.

- [청구항 23] 제 22항에 있어서,
상기 방법은 무기 입자를 유상부 또는 유화 조성물에 첨가하는 단계를 더 포함하는 것인, 유화 조성물을 제조하는 방법.